

3EC-M1S-HTE

- ・ 圧延銅箔同様にアニールにより再結晶する高伸び・高屈曲電解銅箔。
High Elongation and flexibility after annealing, equally with RA copper foil.
- ・ 微細表面処理により、3EC-M3S-HTEよりも更に低粗度を実現。
Lower profile compare with 3EC-M3S-HTE because of S-side surface treatment.

用途/Application

- ・ フレキシブルプリント基板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生産拠点/Production Site

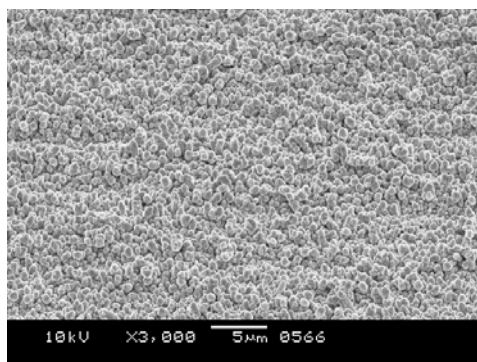
- ・ 日本/Japan

代表的特性値/Representative data

	μm	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μm)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-M1S-HTE	9	78	1.8	390	5	0.6
	12	99	1.8	390	6	0.7

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side



レジ面 resist side

